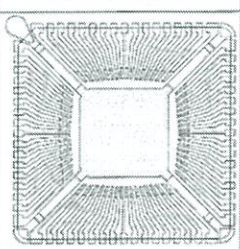
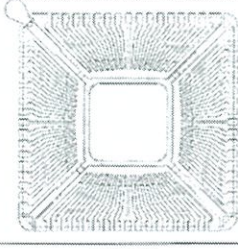


HC32F120 系列 LQFP44 (10x10) 框架扩产的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC32F120H8TA-LQ44	2F120H80-0123B0LQ0T
	HC32F120H8TH-LQ44	2F120H8H-0123B0LQ
	HC32F120H6TA-LQ44	2F120H60-0123B0LQ0T
	HC32F120H8TA-LQ44M	2F120H8M-0123B0LQ

变更原因描述	LQFP44 10X10 封装产能紧张, 封装厂天水华天提出框架从 2 排升级扩产为 5 排, 扩充产能。
--------	---

变更方法描述	1. 框架从 2 排升级扩产为 5 排, 框架的长度从 215.5mm 变更为 250mm, 宽度从 45.7mm 变更为 79.5mm, 但是框架变更前后的内引脚长度没有变化;		
	框架内部结构示意图		框架设计图示
	PAD 尺寸	165×165(mil ²)	
	2 排 (升级前)	PAD 结构	
	镀银方式	全镀银	环镀银
5 排 (升级后)	PAD 尺寸	165×165C(mil ²)	
	PAD 结构		
	镀银方式	环镀银	
2. 框架从 2 排升级扩产为 5 排, 封装芯片外形尺寸和表面印章都无变化。			

变更生效日期或产品 Date Code 说明: 2021/10/30 开始生效

发行人	康超	发行日期	2021/8/26
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署: 孙方军			
		日期:	2021.8.30

客户	部确认意见:
签署:	日期:

✧ 以上, 特此通知, 如果您有任何意见或建议, 请随时与我司销售部门联系。✧

